



Title of Change:	SOIC-8 Insourcing to ON Semiconductor Philippines (OSPI) Factory from GEM (China)	
Proposed first ship date:	10 December 2018	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < Rodrigo.Milana.Jr@onsemi.com >	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < Lalan.Ortega@onsemi.com >.	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	Product marked with date code 1811 or later may be built from current factory or from OSPI Factory. The trace code marking on Line 2 is of the form ALYW where A = Assembly Location, L = Wafer Lot ID and YW is a 2-digit date code. Product marked with "P" as the assembly location will be from OSPI. Additionally on the label of the box and reel, the ASSY LOC: PO will also indicate product assembled in OSPI. Please see sample label on Page 2 at the following URL http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF to see the location of the ASSY LOC.	
Change Category:	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input checked="" type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____	
Change Sub-Category(s):	<input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input checked="" type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input checked="" type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Carmona, Philippines	External Foundry/Subcon Sites: GEM Electronics, China
Description and Purpose:		
This Update Notification is issued to remove following products, FDS8984, FDS8984-F40, and FDS4935BZ from FPCN22191XC. These products will not yet undergo the change described in original FPCN22191XC. These products will be re-aligned to another Qual vehicle to qualify new L/F design. New FPCN split will be issued for these devices, thereafter, upon completion of respective qualification.		
Reliability Data Summary: See original FPCN22191XC		
Electrical Characteristic Summary:		
The temperature characterization meet datasheet specification. Electrical characteristics are not impacted. Detail of Electrical characterization result is available upon request.		
List of Affected Standard Parts:		
Part Number		Qualification Vehicle
FDS8984		FDS8978
FDS8984-F40		FDS8978
FDS4935BZ		FDS6681Z

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



変更件名:	SOIC-8 製品についての GEM (中国) から ON Semiconductor Philippines (OSPI) 工場へのインソーシング	
初回出荷予定日:	10 December 2018	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Rodrigo.Milana.Jr@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN、または最終 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
その他の信頼性データ:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Lalan.Ortega@onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> お願いします。	
変更部品の識別:	日付コード 1811 以降の製品は、現在の工場または OSPI 工場で製造されています。捺印の 2 行目のトレースコードの様式は ALYW となっており、A は組立拠点、L はウェハロット ID、そして YW は 2 桁の日付コードを示しています。組立拠点が「P」と捺印されている製品は OSPI 品です。また、ボックスとリールに貼られたラベルに ASSY LOC: PO の表記があるものは OSPI で組み立てられた製品であることを示しています。ASSY LOC の位置について以下の URL にある冊子の 2 ページ目のサンプルラベルをご参照ください。http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF	
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input checked="" type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____	
変更サブカテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input checked="" type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON カルモナ、フィリピン	外部製造工場または下請け業者拠点: GEM エレクトロニクス、中国
説明および目的:	このアップデート通知は、以下の製品、FDS8984、FDS8984-F40、FDS4935BZ を FPCN22191XC の対象から削除するために発行されました。これらの製品に対して、元の FPCN22191XC に記載された変更は実施されていません。これらの製品においては新しいリードフレームを採用するため、他の認定試験用ピークルにより再度認定試験が実施され、試験の完了後に新たな FPCN が発行されます。	
信頼性データの要約:	元の FPCN22191XC を参照	
電気的特性の要約:	温度特性はデータシートの仕様を満たしています。電気的特性は影響を受けません。電気的試験結果の詳細は要望に応じて入手できます。	
影響を受ける部品の一覧:		
	部品番号	認定試験用ピークル
	FDS8984	FDS8978
	FDS8984-F40	FDS8978
	FDS4935BZ	FDS6681Z



Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle
FDS4935BZ		FDS6681Z
FDS8984		FDS8978